

フリップチップ実装基板

Fine Circuit Pattern, Flip Chip mounting PCB

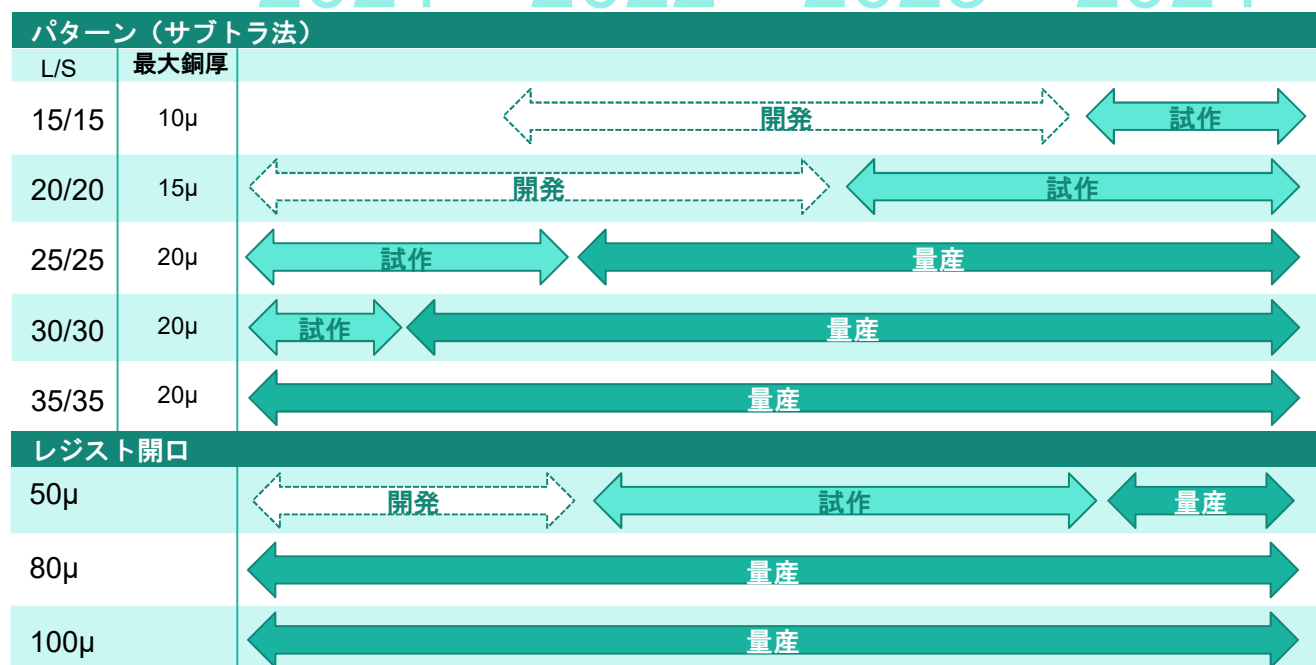


高密度・高機能半導体パッケージ向け 微細パターン・フリップチップ実装基板

5G・小型通信機器・サーバー・FC-BGAなどに求められる高密度・高機能半導体パッケージ、当社はサブトラ法の独自技術により、低コストでの高密度回路形成が可能。コンタクト式露光に加えダイレクトイメージング(DI)露光を用いて、さらなる高密度・高精度な回路形成を実現。

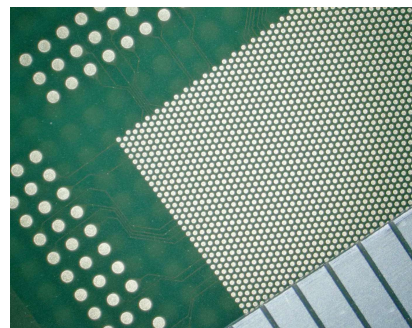
ロードマップ

2021 2022 2023 2024



デザインルール

項目	ファイン (ダイレクト露光)	ファイン (コンタクト式露光)	通常
パターン位置精度 (対スルーホール)	±10μ	±35μ	±50μ
レジスト位置精度 (対パターン)	±30μ	±50μ	±75μ



フリップチップBGA



日本ミクロン株式会社

www.nihon-micron.co.jp

☎ 0266-23-8373

(土日・弊社指定休日を除く8:30~17:20)

✉ nmadpt@nihon-micron.co.jp

FAX 0266-23-1223